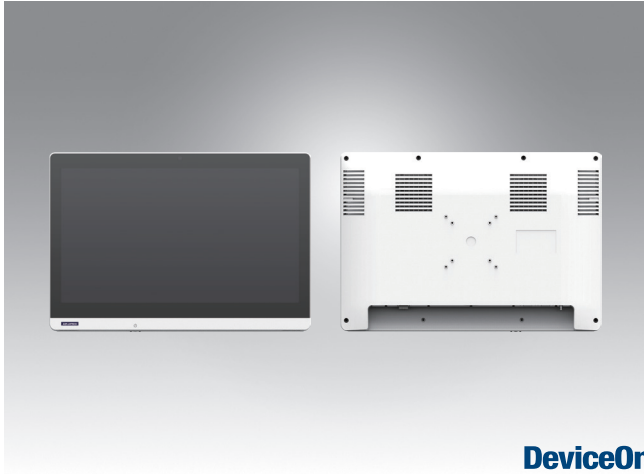


# POC-821 Preliminary

## 21吋医疗级边缘AI一体机，搭载 Intel 第13代 CPU 及 NVIDIA GPU



### 特点

- Intel 13代 Core i7-13700E CPU
- 21.5英寸全高清显示屏，多点触控
- MXM 模块 A2000 / A4500，可支持高阶显卡
- 前面板IP65等级防水防尘
- IEC/UL60601-1医规认证
- 可选Wi-Fi，蓝牙，RFID及摄像头
- 可选配备研华DeviceOn/iService远程设备管理软件
- 双PCIe插槽，用于图形和附加卡扩展



### 简介

POC-821配备了集成SSD，便于实时数据处理和存储。它还支持MXM图形模块和附加卡，如数据采集、高端图形应用程序的I/O扩展。POC-821终端符合IEC 60601-1电气设备医疗安全标准，可在各种医疗环境中可靠运行。

此外，POC-821可选内置配备了研华的DeviceOn/iService软件，这是基于WISE DeviceOn平台的新一代统一设备管理解决方案。DeviceOn/iService支持批处理操作和多设备控制，可轻松配置和部署设备，方便远程设备管理。

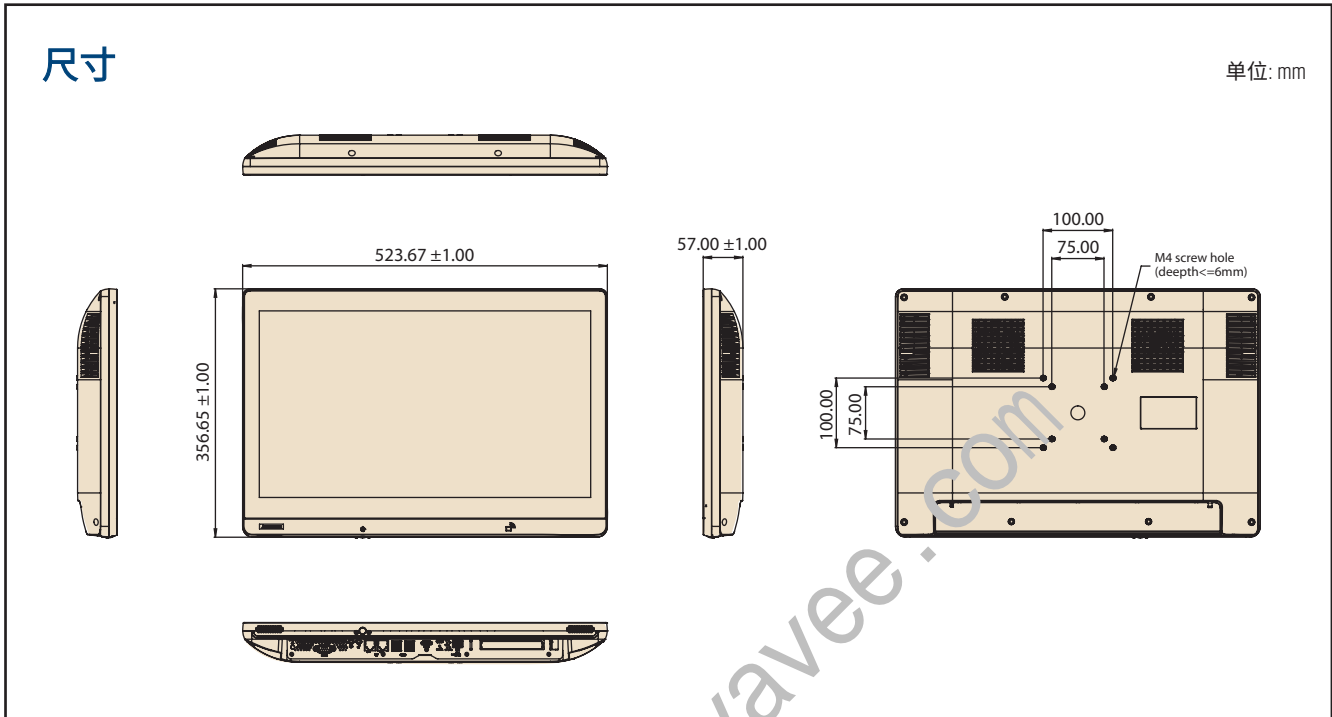
### 规格

系统	CPU* 内存 操作系统 (可选)	Intel® Core™ i7-13700E 处理器, 16 Core, 1.9GHz (24M Cache, up to 5.10 GHz) 支持 DDR5 Memory up to 64GB (可选支持ECC) Windows 10 IoT / Windows 11 IoT (TBD) / Linux (依需求) 仅64 bits
存储	主存储 辅助存储 (可选)	支持 NVME M.2 SSD (高达2TB) 支持 2.5" SATA SSD (高达 2TB)
显示	大小 最大分辨率	21.5" 1920 x 1080全高清
触摸	类型	十点触控电容屏(透明玻璃,可选抗反射防眩玻璃)
显卡	MXM 采集模组 (可选)	NVIDIA A2000 (8GB) or A4500(16GB) MXM MSH mode module
I/O口	DC In USB 3.2 Type-A USB 3.2 Type-C HDMI LAN (Isolation 1.5 KV) 耳机输出 麦克风输入 COM (RS232) (Isolation 1.5 KV)	x 1 x 4 x 1 (带显示功能/DP ALT模式) x 1 x 2 x 1 x 1 x 1
扩展槽	PCIe x 16 PCIe x 4 M.2 2280 M.2 2230	x 1 (该插槽为MXM图形模块预留) x 1 x 1 (用于NVME M.2 SSD主存储) x 1 (用于Wi-Fi/蓝牙模块)
其他功能	扬声器 摄像头 (可选) TPM	x 2 (2W) 500万像素摄像头可用 2.0 (默认)
电源输入	DC	DC input 24V (Adapter 100-240V/AC, max. 300W)
IP等级	前面板	IP65
身份验证解决方案	RFID (可选)	模块可选
认证	EMC & 安全认证	医疗 CE, FCC 医疗 IEC 60601-1 认证 (MDR) UL 60601-1 CCC
外观	尺寸 (W x H x D) VESA安装 重量	523.67 x 356.65 x 57mm (20.6" x 14.01" x 2.24") 100 x 100; 75 x 75 mm 7 kg (15.43 lbs)
环境	温度	操作: 0° C - 35° C 存储: 0° C - 50° C
保固	保固	整机3年

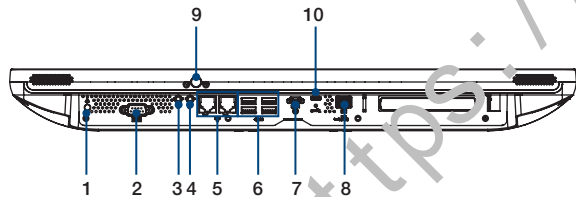
\*依项目需求支持其他CPU,更多细节请洽研华业务人员。

尺寸

单位: mm



I/O 口



- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. 等电位端子引脚          | 6. 4 x USB 3.2 Gen 2 Type A |
| 2. COM Port (RS232) | 7. HDMI                     |
| 3. 耳机输出             | 8. DC-In                    |
| 4. 麦克风输入            | 9. 电源按钮                     |
| 5. 2 x LAN 口        | 10. USB 3.2 Gen 2 Type C    |

## CTOS 服务

### System's 裸机料号

料号	描述	屏幕尺寸	CPU	RAM	触摸类型	SSD
POC-821-12B010-CA	POC-821 Corei7/P-cap/ w/o RAM, SSD, MXM	21.5"	i7-13700E	NA	P-CAP	NA
1970005856T001	(CPU Thermal Module) C.L R4 Intel.-Alder Lake-S 65W 244.7x242.68x27.4	----	----	----	----	----

### MXM GPU 卡 (W/ MXM GPU 卡, MXM载板和MXM热模块)

料号	描述	GPU	GPU MXM 内存
POC-MXM-102-8A	POC-821/824 MXM A2000 package	A2000	8GB
POC-MXM-104-8A	POC-821/824 MXM A4500 80W package	A4500	16GB

### 内存

料号	描述
<b>262pin SO DIMM 4800 - Non ECC</b>	
SQR-SD5N8G4K8SNGBB	262pin SODIMM DDR5 4800 8GB 1.1v 1Gx16 (0-85°C)
SQR-SD5N16G4K8SNBB	262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8 (0-85°C)
SQR-SD5N32G4K8SNBB	262pin SODIMM DDR5 4800 32GB 1.1v 2Gx8 (0-85°C)
SQR-SD5I8G4K8SNGBB	262pin SODIMM DDR5 4800 8GB 1.1v 2Gx8 (-40-95°C)
SQR-SD5I16G4K8SNBB	262pin SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8 (-40-95°C)
SQR-SD5I32G4K8SNBB	262pin SODIMM DDR5 4800 32GB 1.1v 2Gx8 (-40-95°C)
<b>262pin SO DIMM 5600 - Non ECC</b>	
SQR-SD5N16G5K6HNAB	262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0-95°C)
SQR-SD5N32G5K6HNAB	288pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0-95°C)
SQR-SD5N8G5K6SNGPB	262pin SODIMM DDR5 5600 8GB 1.1v 1Gx16 (0-95°C)
SQR-SD5N16G5K6SNPB	262pin SODIMM DDR5 5600 16GB 1.1v 2Gx8 (0-95°C)
SQR-SD5N32G5K6SNPB	262pin SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0-95°C)
<b>262pin SO DIMM 4800 - ECC</b>	
SQR-SD5N16G4K8SEBB	262pin ECC SODIMM DDR5 4800 16GB 1.1v 2Gx8 (0-85°C)
SQR-SD5N32G4K8SEBB	262pin ECC SODIMM DDR5 4800 32GB 1.1v 2Gx8 (0-85°C)
<b>262pin SO DIMM 5600 - ECC</b>	
SQR-SD5N32G5K6SEPB	262pin ECC SODIMM DDR5 5600 32GB 1.1v 2Gx8 (0-95°C)

### NVME M.2 SSD 存储

料号	描述
SQF-C8MV2-256GDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8MV2-512GDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8MV4-1TDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8MV4-2TDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8BV2-256GDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8BV2-512GDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8BV4-1TDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)
SQF-C8BV4-2TDDEM	SQF PCIe/NVMe M.2 2280 OPAL 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20-85°C)

### 2.5" SSD 存储

料号	描述
SQF-S25V1-128GSDSDC	SQF 2.5" SSD 650 128G 3D BiCS5 (0-70°C)
SQF-S25V1-256GSDSDC	SQF 2.5" SSD 650 256G 3D BiCS5 (0-70°C)
SQF-S25V2-512GSDSDC	SQF 2.5" SSD 650 512G 3D BiCS5 (0-70°C)
SQF-S25V4-1TSDSDC	SQF 2.5" SSD 650 1T 3D BiCS5 (0-70°C)
AMF-S25V2-256-DCSDC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 256G 3D TLC (BiCS5) (0-70°C)
AMF-S25V4-512-DCSDC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 512G 3D TLC (BiCS5) (0-70°C)
AMF-S25V4-1T-DCSDC	AMF 2.5" SATA SSD SP111-D 1T 3D TLC (BiCS5) (0-70°C)

\*Note: Additional materials listed under "2.5" SSD mounting kit" for 2.5" SSD installation


### 2.5" SSD 安装套件

料号	描述	数量
1960098903N001	SSD Bracket	1
1940003234	Gasket	1
19330304A0	Screw	8
2130022205T000	Sponge	1
1700024977-21	SATA cable	1
1700022355-21	Power cable	1

### Wi-Fi + 蓝牙模组

料号	描述
EWM-W165M201E	Intel AX210 6E 802.11ax + BT5.2 M.2 2230 No.Vpro

## 推荐底座

名称	ARES-2423R
料号	ARES-2423R-A741L00
产品图	
最大支持重量	6 - 12kg
最大支持尺寸	≤ 27"
VESA 信息	75 x 75 mm 100x100 mm

For more information, please click this link: <https://bit.ly/3T7dLMR>